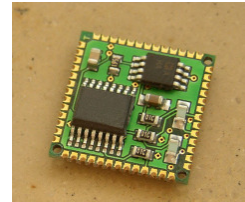


## Baustein zur Signalwandlung – TEM 2.0

### Bestellnummer:

**Baustein** efm-ex-0301-12.5

**Trägerplatine** efm-et-0301-12.5



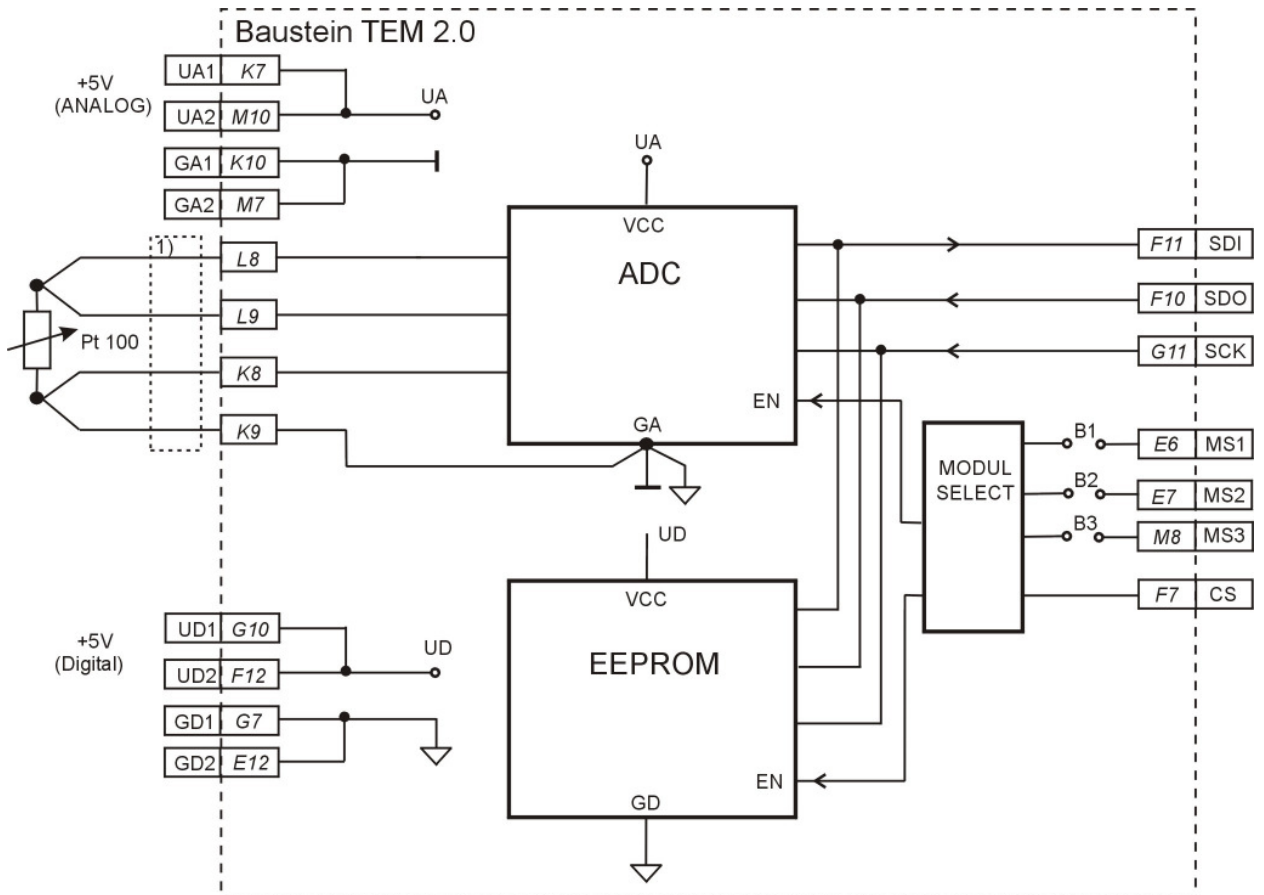
<b>Sensorelement</b>	Pt 100 (4 Draht-Anschluss)
Messgröße	Temperatur
Messbereich	-50 °C bis +250 °C
Abtastrate	6,5Hz
Genauigkeit	0,2K
<b>Baustein-Schnittstellen</b>	
Kommunikation intern <sup>1</sup>	SPI-Bus (Messdaten und EEPROM-Daten)
Kalibrierung	2-Punkt
<b>Baustein</b>	
Spannungsversorgung	+5V DC ±5%
EEPROM	4kByte
Temperaturbereich	-40 °C...+70 °C
Größe	12,5 x 12,5 x 5,2mm <sup>3</sup>
Kompatibilität	Match-X; 0.63 (Pinbelegung siehe Datenblatt)
Kontaktierung	Top: JST-Connector BMO4 <sup>2</sup> Bottom: Land Grid (3µm NiAu) auf Anfrage Bottom als BGA-Struktur, (Sn-Pb63 Balls)
Material	FR4
Zusätzlich	Softwarebibliothek auf Anfrage Baustein für Pt1000 auf Anfrage

<sup>1</sup> Kommunikation zu Bausteinen

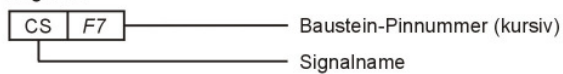
<sup>2</sup> Baustein auf Topseite mit Steckerbaustein TOP2.0 komplettiert, bei Bestellung der einzelnen Trägerplatine beachten: Kein Steckerinterface für Sensoranschluss auf Trägerplatine

## Baustein TEM 2.0

### Blockschaltbild



#### Legende



B = Brücken  
B1 v B2 v B3  
B1 Standardbestückung

1) Pt100-Anschluss über TOP2.0